

令和3年10月22日

関係各位

(一社) 日本実装技術振興協会  
定例講演会  
会長 嶋田 勇三

## 第211回定例講演会のお知らせ

拝啓 時下ますますご清祥のことお慶び申し上げます。  
さて、日本実装技術振興協会の第211回定例講演会の内容が決まりましたのでお知らせいたします。  
今回も新型コロナウイルス感染症対策のため、WEB会議システム（zoom ウェビナー）を利用した開催となります。会場開催での定例講演会と申込内容や開催形式が異なりますので、ご確認いただけますようよろしくお願いいたします。  
ご多忙の中恐縮でございますが、万障お繰り合わせの上、ご参加下さいますようお願い申し上げます。  
ホームページやFacebookでも同定例講演会の情報を配信します。

敬具

### 記

- 開催日時：令和3年11月18日（木）定例講演会 13：10～17：00
- 開催方式：WEB会議システム「zoom ウェビナー」  
（参加申し込みをされた方に後日、招待メールをお送りします）
- プログラム：“実装の課題と進化の行方”

13:10～14:10 プログラムテーマ①	『2021年最新機器の分解から見える3D化される未来』 (株) テカナリエ CEO 清水 洋治氏 講演内容：2021年発売のドローン、スマートフォンなどの分解を通じて見える最新機器の特徴、動向と半導体やシステムの変化をエビデンスベースで紹介し今後の変化を抽出する。
14:10～15:00 プログラムテーマ②	『最新実装トレンドと高信頼性アンダーフィル/サイドフィルによる実装信頼性の向上』 パナソニック デバイスマテリアル販売 (株) 第二営業本部 営業一部 営業一課 溝口 莉菜氏 講演内容：近年、モジュールの小型化・高機能化などのトレンドから、実装信頼性の確保が年々厳しくなっている。その背景として、車載では電子機器の多機能化に伴い、電子基板は高密度実装が求められ、BGAやQFNなどリードレスPKGの実装が増加していることにある。一方で、ADAS（先進運転支援システム）や自動運転への流れから、デバイスへの信頼性要求値が高まり、はんだの接続性が課題になっている。また、サーバーや宇宙、IoTなど高機能化トレンドによる、PKG大型化・はんだ接合部の小型化が顕著であり、実装信頼性の確保が急務である。以上の背景から、車載品質のアンダーフィル、サイドフィル技術でこの課題を解決する同社の取組を紹介する。
15:00～15:10	－ 休 憩 －
15:10～16:00 プログラムテーマ③	『電子部品の最近の動向トピックスと今後の方向性』 TDK (株) 技術・知財本部 材料研究センター 第3材料開発室 室長 石井 大基氏 講演内容：近年、データ処理量の増加に伴い、CPUの処理速度への要求はさらに増加の一途を辿っている。そのため、高密度実装技術への要求も高まり、エレクトロニクス部品における特性の重要性も増加している。本講演では、コンデンサにフォーカスし、高速処理への課題と将来動向について紹介する。
16:00～16:50 プログラムテーマ④	『先端高密度実装に向けた1Stop Smart Solution』 ヤマハロボティクスホールディングス (株) 代表取締役社長 中村 亮介氏 講演内容：近年小型化・高密度化が進む電子部品実装に向けた実装装置技術の動向について、以下の視点で実際の装置事例を使って紹介する。1. 電子部品の小型化に向けた実装関連装置の進化 2. 半導体パッケージ実装の高精度化 3. 電子部品実装と半導体パッケージ実装の融合
16:50～17:00	『トークセッション』 講師の皆様と参加者の皆様とで、意見交換を行う時間を設けます。

4. **参加費：無料** 企業正会員は1社3名まで。また、同じ名前とメールアドレスで複数の方が入室した場合、システム上、入室した人数分利用者がカウントされます。1登録1名様のご利用でお申込みください。

5. **参加申し込み**：ご出欠については、同送致しましたご出欠連絡用紙にご記入の上、E-mailにて **令和3年11月10日（水）迄**にお申し込みいただけますようお願いいたします。

※講演2日前までに、ご参加者各人に招待メールをお送りしますので、ご参加者全員の氏名・メールアドレスをご連絡ください。また、zoom ウェビナーに参加される際には、ご連絡いただきましたメールアドレス・参加者氏名でログインするようお願いいたします。セキュリティの関係上、名簿と合致しない場合、zoom 定例講演会から退場していただく場合がございます。参加者が変更する場合はご連絡ください。

※講演資料は、個人会員と、企業正会員は登録代表者（連絡担当者）に講演日1週間前に郵便で発送させていただきます。

ご不明な点がございましたら下記までお問い合わせ下さいますようお願い致します。

事務局：一般社団法人 日本実装技術振興協会事務局 担当/相良(サガラ)・太田  
携帯：090-5403-1147 (相良)、090-5301-9467 (太田)  
E-mail: [j.jisso.org@gmail.com](mailto:j.jisso.org@gmail.com)  
URL : <http://www.j-jisso.org/index.html>